

硬科技成色提升 并购驶入快车道 资本市场“苏大强”2025年交卷

钱佳滢 记者 仲菡

上市公司是区域经济发展的“顶梁柱”，也是科技创新和产业创新深度融合的“排头兵”。截至2025年12月29日，江苏上市公司数量达722家，占全国总量的1/8，总市值攀升至8.9万亿元，市值较“十三五”末增长46%。其中，千亿元市值公司增至11家，一批科技龙头上市公司脱颖而出。数据显示，江苏在科创板、北交所上市公司数量分别达115家、56家，稳居全国第一。此外，“十四五”时期，江苏上市公司实现首发融资2259.71亿元，再融资3852.79亿元，全国排名第四，为“经济大省挑大梁”提供了坚实支撑。

12月29日，江苏证监局、江苏省上市公司协会共同发布《江苏省上市公司发展报告（2025）》（下称《报告》），系统梳理了江苏上市公司在融资、并购、再融资、研发投入等多方面数据，并归纳总结出资本市场“苏大强”发展特点和经验，为推动江苏上市公司承前启后、系统布局、提升核心竞争力建言献策，助力上市公司群体在服务国家战略和区域经济发展中展现更大担当。

结构优化：江苏上市公司“硬科技”成色提升

《报告》显示：江苏上市公司2025年上半年合计实现营业收入1.7万亿元，同比增长1.2%，占全省GDP比重超1/4；合计实现净利润1527亿元，同比增长3.7%，营收与净利润平均增速均高于全国平均水平。从企业个体表现看：六成公司营收规模扩大，四成公司营收超10亿元，45家公司营收增幅超50%；八成公司实现盈利，五成公司净利润同比增长，137家净利润增幅超50%，成为稳定江苏经济大盘的重要力量。

《报告》重点对资本市场“江苏军团”的科技成分“把脉”。“十四五”时期，江苏持续引导要素资源向高端装备制造、人工智能、生物医药等重点产业链集聚。五年来，江苏新增上市公司257家，其中约九成成为科技企业或科技含量较高企业。截至2025年底，江苏上市公司已覆盖16个先进制造业产业集群和150条产业链，有力推进新型工业化建设。

在科技企业培育方面：目前，江苏在科创板、北交所上市公司数量分别达115家、56家，稳居全国第一；拥有国家级专精特新“小巨人”企业373家，战略性新兴产业上市公司305家，两类企业数量均占全国同类企业约1/6。

资本市场的赋能，也让一批硬科技企业实现跨越式成长。半导体领域代表企业通富微电通过IPO、再融资等方式累计募集资金约107.56亿元，持续扩大产能与经济规



模。截至2024年末，通富微电销售收入、净利润较2020年末均实现翻倍，客户覆盖多数世界前20强半导体企业及国内主流集成电路设计公司，已成长为全球排名第四的准一线封测企业。

生物医药领域代表企业迪哲医药，则借助科创板上市融资实现关键突破。2025年7月，迪哲医药一款创新药获美国FDA批准上市，成为我国首个自主研发、在美获批的全球首创新药，标志着中国源头创新实现从“中国出发”到“全球认可”的关键跨越。

量质齐升：“苏大强”并购重组驶入快车道

“十四五”时期，江苏资本市场并购重组活跃度持续提升，新增披露并购重组1057起，完成573起，完成金额合计3041.98亿元，占全国总量的1/9以上。《报告》指出，特别是“并购六条”发布以来，制度包容性与适应性进一步提升，江苏作为“有能力主体、有效市场、有为政府、有力监管”四个维度构建完善并购重组生态体系，助力全省“筑峰强链”行动，推动“苏大强”并购重组实现量质齐升。

政策端的持续加码，为并购重组疏通了融资渠道。作为全国首批18个科技企业并购贷款试点城市之一，南京落地全国首单5000万元、10年期并购贷款，由工商银行南京分行向当地一家科技上市公司发放，融资比例高达80%，创新实现金融资本对科技企业产业整合升级的精准赋能。

并购重组的创新活力还体现在模式探索上。在无锡，国有企业主动作为，成为并

购重组的活跃主体，创新打造“并购招商”新模式。锡山金投收购洪汇新材、惠山国资收购宁波博汇股份、江阴国资联合半导体产业方收购长龄液压等一系列典型案例，展现了无锡国资通过并购重组优化产业结构、助力当地“465”现代产业集群高质量发展的新路径。

从产业分布看，“并购六条”实施以来，江苏制造业上市公司成为并购重组的主力军，累计发起并购重组216起，主要集中在机械设备、半导体、医药生物等战略性新兴产业领域，其中半导体产业的并购整合尤为引人注目。

2025年，华海诚科以11.2亿元收购衡所华威剩余70%股权，大幅提升公司在半导体环氧塑封料领域的年产量，有望跃居全球出货量第二位。松发股份收购恒力重工于2025年5月获得注册，成为“并购六条”发布后首单落地的跨界并购案。

值得关注的是，在并购重组驶入快车道的同时，并购主体的决策也更趋理性、审慎。2025年，江苏半导体行业并购出现部分终止案例，思瑞浦经审慎研究终止收购奥拉股份，帝奥微因交易方案等条款分歧终止收购荣湃半导体。

生态完善：现金分红、主动回购意愿显著增强

资本市场生态的优化，离不开上市公司的主动作为。“十四五”时期，江苏上市公司累计分红3946亿元，较“十三五”时期增长45.4%；股利支付率提升至37.8%，较“十三五”时期提高4.6个百分点，其中103

家上市公司累计分红金额超过其股权融资金额，用实际行动回报投资者。2025年，江苏全省有162家公司计划开展中期分红，同比增长11.72%。

股份回购方面同样表现亮眼。“十四五”时期，江苏上市公司累计回购金额达523亿元，是“十三五”时期的2.6倍。政策支持进一步强化回购增持力度，截至目前，全省已有70家公司获批专项贷款开展回购增持，获批额度近140亿元。通过持续稳定的现金分红、积极主动的股份回购与增持，江苏上市公司有效提振市场信心，维护公司价值，在资本市场波动中发挥了关键的“稳定器”作用。

江苏证监局近年来持续强化监管精准性和有效性，推动形成规范有序的市场生态，推动上市公司关键少数提高规范运作的自觉性。同时，加大立案追责力度，“十四五”时期，江苏证监局共对27家上市公司作出行政处罚。

与此同时，江苏证监局会同金融主管部门、当地司法机关，共同加大投资者保护力度。2024年，江苏证监局联合南京市中级人民法院成立了全国首家证券融合法庭——“宁法挺您”证券融合法庭。成立一年来，该融合法庭为649名投资者挽回4500余万元，入选中国证监会2025年度投资者保护示范案例。

江苏证监局表示，未来将支持股权、债券等直接融资发展，鼓励上市公司不断做优做强，以科学有效的监管构建规范有序的市场生态，助力培育世界一流企业，助推“强富美高”新江苏现代化建设。

■ 董事长专访

美利云田生文：在沙漠边缘铸绿色算力高地

记者 于瑶

在腾格里沙漠边缘，美利云C1机房拔地而起，凭借卓越绿色节能实践，被工业和信息化部评选为2025年度国家绿色数据中心。关停传统造纸业务，转向新能源赛道，并以“绿电”驱动“绿算”，战略性新兴产业的培育孵化使美利云发生“脱胎换骨”的变化。近日，上海证券报记者与公司董事长田生文面对面交流，探究美利云在国家“东数西算”与“双碳”目标大背景下，如何优化“数据中心+新能源”组合式发展，重塑企业核心竞争优势。

剥离造纸，聚焦算力

造纸业务曾经为美利云贡献了七成营收，但是近年来该业务持续亏损且扭亏无望，成了公司的“出血点”。通过深入研判，美利云决定进行战略性调整，明确“绿色数据中心+绿电”双轮驱动发展模式。

“2016年，我们把握数据存储与算力需求爆发机遇，突破传统行业局限，通过非公开发行股票建设数据中心，成功跨界云计算；2018年，公司又基于自身资源拓展光伏新能源，构建差异化竞争力建成50兆瓦光伏电站。2024年，美利云数据中心收入同比增长24.66%，达到3.12亿元，且毛利率很高，显著高于原来的造纸业务，验证了转型方向的正确性。”田生文说。

宁夏中卫市是“东数西算”的国家算力枢纽节点之一。截至目前，美利云已在中卫市建成6栋数据中心机房，其中E1、E3、C1已全面交付客户使用，整体上架率超94%；B1、B3、C3已完成土建工程，具备后续快速投产条件。2025年上半年，公司数据中心业务实现收入占比高达92.68%，已成为公司绝对核心主业。

“与东部沿海数据中心相比，我们的数据中心绿色低碳优势突出：中卫年均气温8.8℃，全年可实现全自然风冷，PUE稳定控制在1.2左右；可利用的绿电资源丰富，中卫光伏资源充足，能够支撑数据中心实现高比例可再生能源消纳；区位优势显著，中卫是全国光纤网络几何中心，至北京、上海、深圳等东部核心城市的网络时延压缩至20毫秒以内，在‘西算’集群中处于领先水平。”田生文说。

目前，美利云数据中心聚焦于夯实基础设施底座，确保服务品质与运营可靠性，盈利模式以定制化机柜托管服务为主，涵盖机架租赁、电力保障、网络接入及7×24小时专业运维等全链条服务。

算电融合，强化优势

随着算电协同加速推进，特别是算力和绿电融合发展，数据中心单机架耗电量和成本持续降低，绿色算力已深度融合各领域。

美利云构建了覆盖数据中心全生命周期的自主能力体系。目前，美利云在设计端拥有37项相关知识产权，具备模块化、标准化、绿色化的设计能力。美利云数据中心C1机房楼大规模应用间接蒸发冷却、直接新风自然冷却等先进技术，成为国内领先的绿色算力综合服务商。

“建设绿色数据中心，除了大规模使用绿电外，通过先进技术提升数据中心的能源利用率，也是一个重要的考量因素。我们构建了一套以100%自然新风冷却为主用方案，融合间接蒸发冷却、直接新风自然冷却等尖端系统的综合性解决方案，并通过智能化管控工具的精准调控，最大限度实现数据中心热量的高效转移以及对冷量的按需、精准分配。”田生文说，经过一年多的努力，美利云数据中心的PUE值下降，核心PUE指标同比降低2.25%。

今年以来，美利云业绩强劲反弹，上半年实现净利润1988万元，同比扭亏，净资产收益率提升至1.5%。

目前，美利云坚定发展数据中心的信心，正在深耕绿色算力产业，以“绿电”驱动“绿算”发展，大力推进110kV变电站建设和源网荷储一体化项目，全力建设宁夏首个“风光储充+智慧”数据中心。

差异竞争，应对挑战

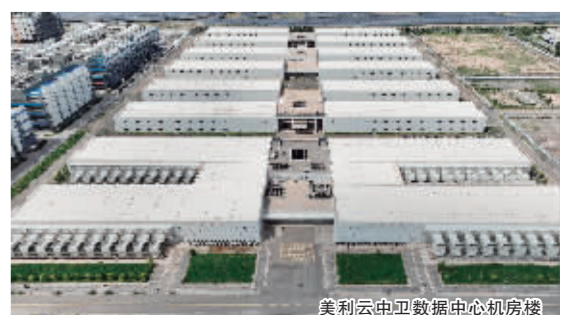
当前，算力需求爆发式增长。对数据中心来说，不能只做单一的机柜租赁业务，而是要围绕人工智能相关产业，夯实业绩基础，稳通算、拓智算，打造绿色低碳智算中心。

据田生文介绍，美利云绿色低碳数据中心是以高效节能的自然冷却技术为核心，面向客户提供高标准、网络接入及一体化运维服务，构建安全、稳定、绿色的算力基础设施。

各地数据中心纷纷建设，行业竞争不容忽视。“‘十五五’期间，美利云面临的竞争压力主要来自两方面：一是三大通信运营商依托网络资源与资本实力加速扩张，形成规模效应；二是第三方服务商同质化竞争加剧，可能导致价格压力与毛利率下行。”田生文说。

对此，美利云将坚持差异化、特色化发展，围绕国家“数字中国”战略，布局“东数西算”，致力成为国内领先的绿色算力综合服务商。

“我们拥有土地、绿电等资源优势，应对策略是谋划‘生态网、绿能网、算力网’的深度融合，深耕宁夏中卫国家算力枢纽节点，提升服务品质与客户黏性。坚持绿色低碳引领，通过深化‘源-荷’协同，打造零碳数据中心样板。开放协同融入产业链，上游与设备厂商、绿电企业合作保障供给，中游与云服务商、网络运营商协同优化算力网络，下游拓展金融、互联网、政务等行业应用场景，构建共生共赢的数字基础设施生态圈。”田生文说。



强一股份：以探针卡守“中国芯”

钱佳滢 记者 仲菡

12月30日，国产探针卡龙头企业强一股份登陆科创板，成为科创板第600家上市公司，同时也是苏州年内新增的第11家A股上市公司。

探针卡，虽处半导体产业核心硬件的细分赛道，却是芯片出厂前不可或缺的“质量守门员”，也是晶圆测试阶段的“消耗型”基础元件。

自2015年成立以来，强一股份从悬臂探针卡、垂直探针卡等传统产品起步，逐步向高附加值MEMS探针卡领域突破。凭借全系列探针卡供应能力，公司实现从技术积累到业绩跨越式增长的进阶，成为唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。

“我们始终怀揣一份愿景：让中国半导体产业在核心硬件领域拥有自主选择权。探针卡直接关乎产业链安全，我们希望以探针卡技术突破为支点，助力半导体产业高质量发展，这也是我们久久为功的核心动力。”强一股份董事长周明近日在接受上海证券报记者专访时表示。

精益求精铸就高附加值

作为一家科创板上市公司，强一股份的“硬科技”底色体现在何处？聚焦探针卡，强一股份截至2025年9月30日已取得相关专利182项，构建起全链条自主技术壁垒，推动MEMS探针卡实现国产化。

探针卡虽是半导体产业链中较为细分的一环，但从研发、设计到生产的全流程，均需倾注工匠精神。

强一股份董事、副总经理于海超告诉上海证券报记者，探针卡的研发难点集中在高精度制造、技术同步迭代、核心部件自主可控等方面。

拆解探针卡的核心结构，主要包括探针、转接基板、PCB等部件。

探针，是探针卡核心中的核心。“根据晶圆测试的需要，一张探针卡可以装配数百至数万支探针，如果其中一支探针偏离了几微



米，这张探针卡就无法使用。此外，这些探针需保持在同一水平面，针尖的水平误差不能超过25微米，否则就可能扎坏待测晶圆。”于海超介绍，除了要在微米级精度下实现微米级探针的精准装配，探针本身还需具备适配高功耗芯片测试需求的优异电学性能，以及实现可靠电气连接的稳定机械性能。

负责连接探针与PCB的转接基板则需实现与探针之间的高平面度配合，适应高温测试环境下的热膨胀匹配，并保障高频信号的完整性。公司探针卡所采用的PCB层数，则远高于普通电子产品常用的PCB层数。

“虽属细分领域，但探针卡的技术壁垒显著，因此带来高附加值。”数据显示：2022年至2024年及2025年上半年，强一股份分别实现营业收入2.54亿元、3.54亿元、6.41亿元和3.74亿元；归母净利润分别为0.16亿元、0.19亿元、2.33亿元和1.38亿元，业绩实现跨越式增长。

自主初心驱动技术迭代

十余年知名半导体外资企业的从业积淀，使周明在创办强一股份之初，便敏锐洞察到探针卡行业“刚需且国产空白”的关键机遇。“我们深知探针卡作为晶圆测试的核心消耗型硬件，是芯片良率控制和成本

优化的关键环节——没有它，先进制程芯片的量产无从谈起。”周明说。

怀揣推动半导体产业链自主可控的创业初心，强一股份瞄准国内芯片设计与晶圆制造企业提供可靠的本土供应这一目标，持续通过自主研发打破技术壁垒。

创业初期，强一股份以悬臂探针卡、垂直探针卡为核心业务。立足行业机遇，强一股份创立伊始便与瑞芯微、华虹集团、复旦微电等知名厂商奠定合作关系。

伴随我国晶圆产能快速扩张，探针卡需求日益增长。在加码悬臂、垂直探针卡设计制造能力的同时，强一股份设立研发部门，开始探索MEMS技术。“采用MEMS方案做探针，好处显而易见——能够同时满足大批量制造和产品性能一致性需求。”周明表示。

2018年，强一股份建成MEMS工艺车间。两年后，2D MEMS探针卡顺利量产。2022年至2024年，强一股份累计研发投入占同期营业收入的17.40%。高研发投入下，公司陆续实现薄膜探针卡量产、2.5D MEMS探针卡验证。

“由于探针卡具有高度定制化的特征，通过技术迭代持续为客户提供匹配需求的服务，是探针卡厂商的核心竞争力。”周明说。从客户矩阵来看，强一股份与多类半

导体产业核心参与者达成合作，公司单体客户数量合计超400家。

行业趋势勾勒未来路径

站在公司上市新起点，周明感到，“技术扎根，趋势领航”是强一股份过往的坚持，也是未来的方向。

与客户深度交流是强一股份感知行业趋势的重要途径之一。“这两年我们有一个直观的体会，客户对封装效率和产品性能的要求越来越高。”周明举例称，目前公司大批量出货产品的探针尖端间距为80微米，伴随客户封装间距不断缩小，公司下一代产品已规划向70微米及以下演进。

除间距微缩外，芯片面积增大、单位面积性能提升、封装结构日趋复杂等因素都对探针卡提出新要求。在射频、光电等特色工艺芯片领域，快速提升的测试频率也为探针卡材料选型、工艺控制等设下更为严苛的标准。

基于对技术迭代趋势的判断，强一股份当前的研发重点聚焦优化2D/2.5D MEMS探针卡的精密性、稳定性及耐损耗性，同时推动2.5D/3D MEMS探针卡在HBM、DRAM等存储领域落地，并拓展汽车电子、工业芯片等场景的可靠性测试方案。此外，公司正持续推进薄膜探针卡高频测试能力升级，攻坚空间转接基板、贵金属电镀液等关键部件的自主研发。

强一股份本次IPO拟募资15亿元，用于南通探针卡研发及生产项目、苏州总部及研发中心建设等项目。前者拟通过新建生产用房及引进先进生产设备，建设2D/2.5D MEMS探针卡及薄膜探针卡产能；后者将研究“45μm Fine Pitch 2D MEMS垂直探针卡”“50μm Pitch DRAM探针卡”“陶瓷封装基板”“贵金属电镀液”等材料或产品课题。

“以上市为新起点，强一股份将继续深耕探针卡领域，紧跟半导体先进制程与新兴应用，以技术突破打破行业壁垒，满足不同客户各类晶圆测试需求，力争成为具有全球市场竞争力的探针卡厂商。”周明说。